

## JEITA 電子実装技術標準化 活動報告会2018

～ コネクテッドインダストリーズが描く将来像 ～

日時 平成30年7月10日(火) 10:00～17:00 (受付開始 9:30～)

場所 機械振興会館 ホール(地下2階)

主催 一般社団法人 電子情報技術産業協会

企画 JEITA/実装技術標準化専門委員会

P

## Program

司会 山田 浩 JEITA 実装技術標準化専門委員会 副委員長 (株)東芝

10:00～10:05	主催者挨拶 二宮 良次 JEITA 実装技術標準化専門委員会 委員長 東芝デバイス&ストレージ(株)
10:05～10:10	来賓挨拶 杉本 綾美氏 経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 電子デバイス係長

## 第1部 - Society5.0に向けた日本の国際標準化戦略 -

10:10～10:40	Society5.0に向けたコネクテッドインダストリーズが描く将来像 野口 康成氏 経済産業省 産業技術環境局 国際電気標準課 統括基準認証推進官
10:40～11:00	IEC/TC91 (Electronics Assembly Technology) のアクティビティ 岡本 正英 IEC/TC91国際幹事 (株)日立製作所

## 第2部 - 電子実装技術 (IEC/TC91) での国際標準化活動 -

11:00～11:20	METIプロジェクト「三次元電子モジュールの外形及び電気的試験方法に関する国際標準化」 春日 壽夫 IEC/TC91 WG6コンベナー 基準認証イノベーション技術研究組合
11:20～11:40	IEC 61189-5-601「はんだ接合部のリフローはんだ付け性およびプリント配線板のリフロー耐熱性試験方法」 杉野 成 IEC/TC91 WG3エキスパート 富士通アドバンステクノロジー(株)
11:40～12:00	IEC 60068-2-82「電気・電子部品のウイスカ試験方法」 坂本 一三 IEC/TC91 WG3エキスパート オムロン(株)

休憩 (昼食は各自にてお願い致します)

## 第3部 - 次世代パワーデバイス実装に関する国際標準化 (METIプロジェクト) -

13:00～13:15	METIプロジェクト「パワーデバイス実装に関する国際標準化」の概要 岡本 正英 パワーデバイス実装の国際標準化研究委員会 副委員長 (株)日立製作所
13:15～13:45	「パワーデバイス実装に関わる国際標準化」ディスクリートタイプパワーデバイスの成果 西川 宏 パワーデバイス実装の国際標準化研究委員会 副委員長 大阪大学 教授
13:45～14:15	「パワーデバイス実装に関わる国際標準化」モジュールタイプパワーデバイスの成果 荻谷 義治 パワーデバイス実装の国際標準化研究委員会 委員長 芝浦工業大学 教授
14:15～14:30	パワーデバイス実装に関するIEC国際標準化提案 山本 剛 IEC/TC91 WG3エキスパート 富士通アドバンステクノロジー(株)
14:30～14:45	METIプロジェクト「電力半導体デバイスに関する国際標準化」プロジェクト 高橋 浩之 (株)東芝 研究開発センター

休憩

## 第4部 - JEITA実装技術標準化専門委員会 最新活動トピックス報告 -

15:00～15:15	JEITA実装技術標準化専門委員会の標準化戦略 二宮 良次 JEITA 実装技術標準化専門委員会 委員長 東芝デバイス&ストレージ(株)
15:15～15:40	JEITA「スルーホールリフロー実装に係る要求事項」標準化プロジェクト 水谷 誠 JEITA スルーホールリフロー実装に係わる要求事項標準化PG委員 ソニーGM&O(株)
15:40～16:05	JEITA「ウイスカ試験方法研究会」-低温実装でのウイスカ発生検証 斎藤 彰 JEITA ウイスカ試験方法研究会 副主査 (株)村田製作所
16:05～16:30	JEITA「サーマルマネジメント標準化検討」-電子機器実装におけるサーマルマネジメント 平沢 浩一 JEITA サーマルマネジメント標準化検討G副主査 KOA(株) 国峯 尚樹 JEITA サーマルマネジメント標準化検討G委員 (株)サーマルデザインラボ
16:30～16:55	JEITA「接合耐久性試験方法」-はんだ接合耐久性に関わる試験方法の標準化 山本 剛 JEITA 接合耐久性試験方法G主査 富士通アドバンステクノロジー(株)
16:55～17:00	閉会挨拶 反保 昌博 JEITA 実装技術標準化専門委員会 副委員長 (株)村田製作所

プログラムの内容につきましては、変更となる場合もありますので、予めご承知おきください。

## ご挨拶

当協会では、「実装技術標準化専門委員会」を中心に1997年からはんだの鉛フリー化に代表されます、環境に配慮した実装技術開発活動に取り組んで参りました。また、これらの活動成果は、毎年『報告会』を開催し、広く普及を図って参りました。今年も『JEITA 電子実装技術標準化 活動報告会』として、この一年間の先端的な実装技術の検討結果をご報告させていただきます。

今回は、産業全体にかかわる動向のご紹介として、Society5.0の実現に向けての産業政策について経済産業省からご講演いただき、その後、実装技術標準化にかかわる活動として、JEITAとしてのMETIプロジェクト「三次元電子モジュールの外形及び電氣的試験方法に関する国際標準化」及び「パワーデバイス実装に関わる国際標準化」をはじめ、はんだ接合部のリフローはんだ付け性に係る標準化について等、多岐にわたるテーマについてご報告させていただきます。

他にも、信頼性の観点で再度規格改定が議論されています電気・電子部品のウイスカ試験方法の改定活動状況及びスルーホールリフロー実装にかかわる要求事項の標準化、「実装技術標準化専門委員会」が独自に取り組んでいる活動として、近年の高密度実装に伴い課題となってきました熱問題に関する標準化への取り組みについての報告も行わせていただきます。関係各位におかれましてはご多用中とは思いますが、是非ご参加いただき、忌憚のないご意見、活発なご討論を賜りますようお願い申し上げます。

JEITA 実装技術標準化専門委員会 委員長 二宮 良次〔東芝デバイス&ストレージ(株)〕

■日 時 平成30年7月10日(火) 10:00~17:00 (受付開始9:30~)

■場 所 機械振興会館 ホール(地下2階)  
東京都港区芝公園3-5-8  
<http://www.jspmi.or.jp/kaigishitsu/access.html>

■申込方法 下記のURLに必要事項を入力してください。  
折り返し「参加受付完了メール」が自動送信されます。  
当日、本メールをプリントアウトの上、会場受付にご提示ください。  
また、ご登録の宛先に「請求書」をお送り致します。  
[https://www.jeita.or.jp/cgi-bin/form\\_tss/form.cgi](https://www.jeita.or.jp/cgi-bin/form_tss/form.cgi)

■申込期限 平成30年7月3日(火) 必着

■定 員 200名  
(定員になり次第締め切らせていただきますので、お早めにお申し込みください。)

■参加費 会員 10,000円(税込)  
一般 15,000円(税込)

■配布資料 活動報告書(当日配布致します)

■お問合せ先 一般社団法人 電子情報技術産業協会  
標準化センター(塩川・澤田)  
TEL:03-5218-1059 FAX:03-5218-1078  
E-mail:d-shiokawa@jeita.or.jp

## 会場へのアクセス



## 最寄駅のご案内:

東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩8分  
都営地下鉄三田線「御成門駅」徒歩8分  
都営地下鉄浅草線「大門駅」徒歩10分  
JR山手線・京浜東北線「浜松町駅」徒歩15分

※お申込み時に入力いただきました個人情報は、本セミナーの受付、次回ご案内のために使用致します。  
他の目的で使用することはありません。

※JEITAの個人情報保護方針につきましては、以下をご参照ください。

<https://www.jeita.or.jp/japanese/privacy/>